

## **LPKF ist bereit für die steigende Nachfrage nach Glassubstraten in der Halbleiterindustrie**

*Garbsen, 13. Mai 2024* - Die Halbleiterindustrie verlagert sich von organischen und Siliziumsubstraten hin zu Glas. Die ausgereifte LIDE-Technologie von LPKF ermöglicht den Übergang in diese neue Ära vom Kleinserienprodukt zur Großserienfertigung.

Kontakt:  
Dr. Isabell Goldberg  
Isabell.goldberg@lpkf.com  
Tel. +49 5131 7095-1795  
Fax +49 5131 7095-90

### **Große Veränderungen im Halbleitermarkt**

Neue Entwicklungen im Rechenzentrums- und Automobilmarkt erfordern neue Halbleiterlösungen. Diese Marktnachfrage wird durch Trends wie Hochleistungs-Computing, Remote-Arbeit, künstliche Intelligenz (KI) und selbstfahrende Autos angetrieben.

LPKF  
Laser & Electronics SE  
Osteriede 7  
30827 Garbsen  
www.lpkf.de

Vorstand:  
Dr. Klaus Fiedler (CEO)  
Christian Witt (CFO)

Aktie:  
Prime Standard  
ISIN 0006450000

Wesentliche Herausforderungen für die Halbleiterindustrie sind dabei das wettbewerbsfähige Preisniveau bei der Herstellung von Halbleiterlösungen, die Differenzierung in den Lieferketten und neue Anforderungen aufgrund sich verändernder Märkte. Dadurch entwickelt sich der Halbleitermarkt rasant weiter.

Namhafte Akteure der Halbleiterindustrie haben Glas als vielversprechende neue Lösung eingeführt, um die industriellen Anforderungen in den Bereichen Hochleistungs-Computing und KI-Anwendungen zu erfüllen. Sie haben kürzlich angekündigt, dass Glassubstrate der neue Marktstandard werden.

### **Advanced Packaging mit Glassubstraten**

Das Mooresche Gesetz verlangsamt sich. Die Lösungen der Halbleiterindustrie, um diese Verlangsamung zu kompensieren, sind Advanced Packaging und heterogene Integration. Dies wird durch die Verwendung verschiedener Chips erreicht, die mit unterschiedlichen, fortschrittlichen Herstellungsverfahren produziert und anschließend in einem Halbleiterpackage verbaut werden.

Ein wichtiger Baustein für Advanced Packaging und heterogene Integrationen ist Glas als Substratmaterial. Es dient als Lösung zur Bewältigung von Verpackungsherausforderungen mit Materialien wie Silizium und organischen Stoffen.

Seit vielen Jahren investiert LPKF in Forschung, Prozesse und Produktentwicklung und hat einen Reifegrad erreicht, um Produktionskapazitäten für die Großserienfertigung bereitzustellen. "Unsere Technologie hat einen herausragenden Reifegrad erreicht, um die Anforderungen der Halbleiterindustrie zu erfüllen. Aus diesem Grund haben wir unsere Produktionskapazitäten im Jahr 2024 erhöht, um

der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden", sagt Dr. Klaus Fiedler, CEO von LPKF.

In den letzten 10 Jahren hat LPKF seine industriellen Prozesse für die Glasherstellung mit höchsten Qualitätsstandards und mit Fokus auf Durchsatz entwickelt, um industrielle Anforderungen zu erfüllen. Das von LPKF entwickelte LIDE-Verfahren (Laser Induced Deep Etching) ist gut etabliert. Glassubstrate von 100µm bis 1,1mm können schnell, präzise und ohne Beschädigungen wie z.B. Mikrorisse verarbeitet werden. Dies ist für die Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz des Gesamtsystems unerlässlich.

### **Hohe Prozessreife der LPKF-Technologie**

Hohe Prozessreife und greifbarer operativer Leistungsnachweis überzeugten namhafte Akteure der Halbleiterindustrie von einer Zusammenarbeit mit LPKF. LPKF unterstützt Kunden bei der Einführung von Glaskernen für Advanced Packaging-Anwendungen, indem es die Technologie in die Herstellungsprozesse der Kunden integriert oder Fertigungsdienstleistungen durch seine Vitriion-Division anbietet. Mit Dutzenden von weltweit installierten Maschinen und Tausenden von hergestellten Glassubstraten in der LPKF-eigenen Produktionsstätte stellt LPKF die Reife der Technologie unter Beweis.

"Global Player schätzen die hohe Präzision, Flexibilität und Designfreiheit der LIDE-Technologie", betont Dr. Roman Ostholt, Geschäftsführer Electronics bei LPKF. Die langjährige Erfahrung und Präsenz von LPKF am Markt ist ein zusätzliches Plus. Dies ist der Grund für die Zuverlässigkeit und die steigende Nachfrage nach den technologischen Lösungen von LPKF aus der Halbleiterindustrie.

Herausragendes Know-how und Qualität, die Fähigkeit, den Marktanforderungen gerecht zu werden und Industriepartner beim Einstieg in den Einsatz von Glassubstraten in der Halbleiterindustrie zu unterstützen, machen LPKF zu einem zuverlässigen globalen Partner.

Weitere Informationen finden Sie hier: <https://lide.lpkf.com/de>

### **Über LPKF**

Die LPKF Laser & Electronics SE ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).